

展示会出展報告 第21回ファインテック・ジャパン

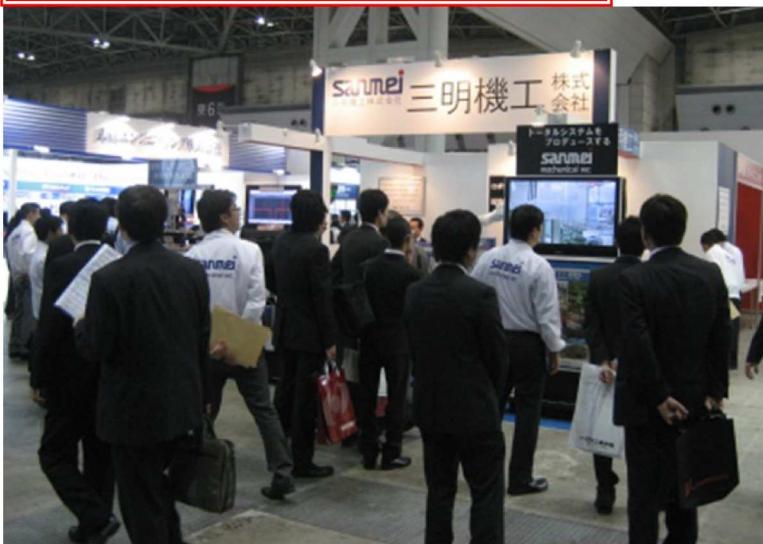
4月13日～15日に東京ビッグサイトで行われた「第21回 ファインテック・ジャパン」に
出展致しました。

今年も4月13日から15日の3日間、東京ビッグサイトで開催されたファインテックジャパンに三明機工が出展しました。
今回は現在世の中で需要が増えてきておりますスマートフォンなど小型で薄型のガラス搬送が今後増えるということ
を睨み、極薄基板での非接触搬送を世の中にアピールすることをテーマに出展しました。

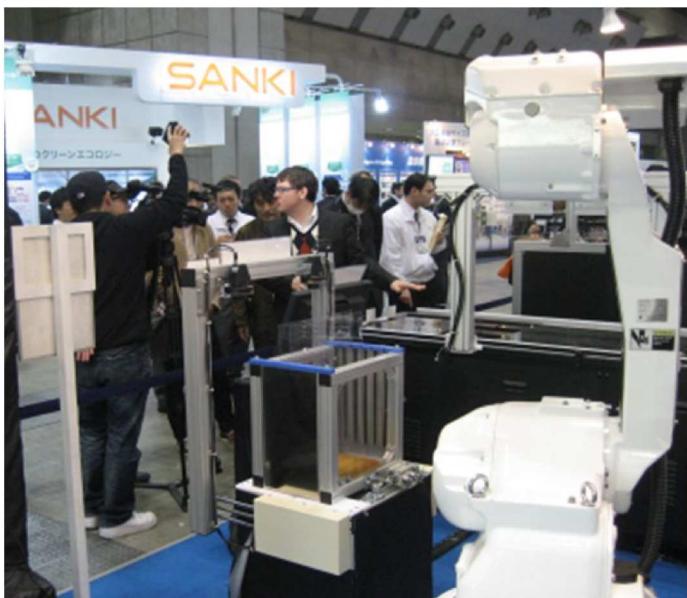
今年は東日本大震災の影響も懸念されておりましたが、3日間の総入場者数55,000人もの来場があり、当社ブース
では、名刺を頂いたお客様だけでも625名と例年を上回る結果となりました。お客様もフィルム関係のお客様が非常に
多く、液晶パネル生産が中国に移行してきている中、今後はフィルム関係の動きが活発になることを予感させる展示会
でした。

三商の営業の方々、また 出展関係者 御協力 誠に ありがとうございました。

会場スナップ写真



今回NHKワールドの取材があり、当社ブースが紹介さ
れました。動きのある実機を展示している企業が
あまりない中、当社のブースはすべて動きのある実
機を展示しており、注目を集めたと思います。
海外に向けてのよいPRにつながりました。

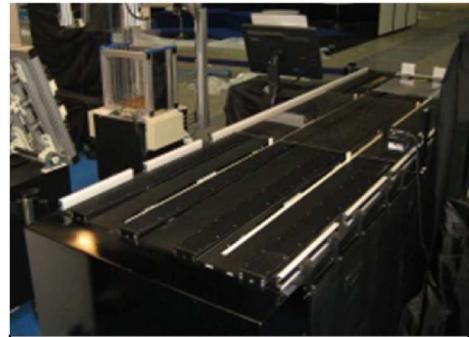


展示会出展報告 第21回ファインテック・ジャパン

展示品概要説明



非接触ハンド



フロートコンベア

当社が独自に開発したフロートパイプを使用した
低脈動且つローコストな基板浮上搬送コンベア

フロートチャックを採用した非接触ガラス搬送
ロボットハンド



遠隔監視システム

遠く離れたユーザーの設備状況、異常状態・履歴などを
自社にいながらにして監視可能。的確な対応を迅速に取ることに寄与し、ダントンタイム短縮につながる。
(株)デジタル殿提供)



ケース梱包システム

ガラスの外周5mm以内は非接触にてロボットが
基板をハンドリングし、ケースに挿入するシステム
画像処理を駆使し、ケースの溝の位置ずれも
ロボットにて吸収し、梱包時の割れ「ゼロ」。